

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2019年4月4日(04.04.2019)



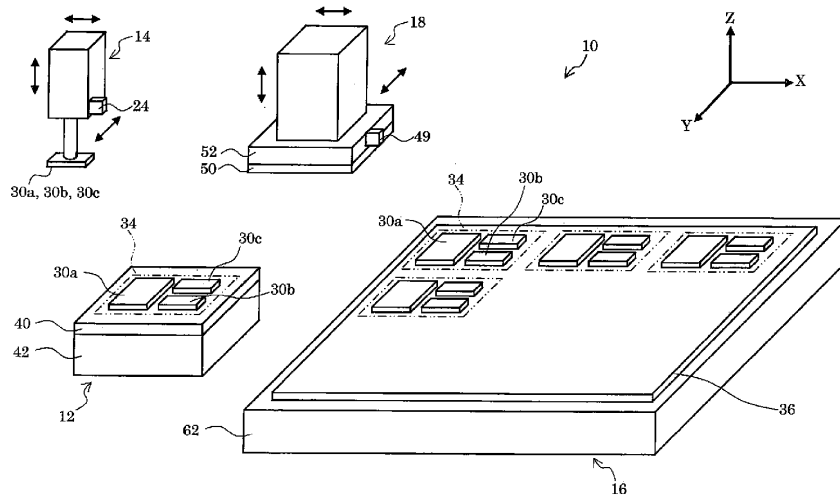
(10) 国際公開番号

WO 2019/065394 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/60 (2006.01) H05K 13/04 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2018/034575
- (22) 国際出願日: 2018年9月19日(19.09.2018)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2017-190058 2017年9月29日(29.09.2017) JP
- (71) 出願人: 株式会社新川(SHINKAWA LTD.) [JP/JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平2丁目51番地の1 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 中村 智宣(NAKAMURA, Tomonori); 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平2丁目51番地の1 株式会社新川内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人 Y K I 国際特許事務所(YKI INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS); 〒1800004 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目34番12号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,

(54) Title: MOUNTING DEVICE

(54) 発明の名称: 実装装置



(57) Abstract: [Problem] A semiconductor mounting device for mounting chip components on a substrate, wherein the device is reduced in size. [Solution] A semiconductor mounting device 10 comprises: a temporary placement stage 12 on which are loaded a plurality of chip components 30a, 30b, 30c; a conveyance head 14 that conveys the chip components 30a, 30b, 30c to the temporary placement stage 12, and also loads each of the chip components 30a, 30b, 30c on the temporary placement stage 12 so that the relative positions of the plurality of chip components 30a, 30b, 30c reach

[続葉有]

WO 2019/065394 A1

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

predetermined positions; a mounting stage 16 that secures a substrate 36 by suction; and a mounting head 18 that suctions the plurality of chip components 30a, 30b, 30c loaded on the temporary placement stage 12, and pressurizes while keeping the relative positions at prescribed positions on the substrate 36 that is secured by suction to the mounting stage 16.

(57) 要約: 【課題】基板へチップ部品を実装する半導体実装装置において、装置を小型化する。【解決手段】半導体実装装置10は、チップ部品30a, 30b, 30cが複数載置される仮置きステージ12と、仮置きステージ12にチップ部品30a, 30b, 30cを搬送すると共に、複数のチップ部品30a, 30b, 30cの相対位置が予め定められた位置になるように各チップ部品30a, 30b, 30cを仮置きステージ12に載置する搬送ヘッド14と、基板36を吸着固定する実装ステージ16と、仮置きステージ12に載置された複数のチップ部品30a, 30b, 30cを吸着し、実装ステージ16に吸着固定されている基板36の所定位置に相対位置を保って加圧する実装ヘッド18と、を備える。